

特点:

- 高的频率稳定度
频率稳定度达 $\pm 1 \times 10^{-6}$
- 低的相位噪声
相位噪声: $\leq -95\text{dBc/Hz}@10\text{kHz}@1.06\text{GHz}$
- SMT 封装
- 封装尺寸: $12.8 \times 12.8 \times 8\text{mm}^3$
- 产品执行标准为 SJ20527A-2003

性能参数 (25°C):

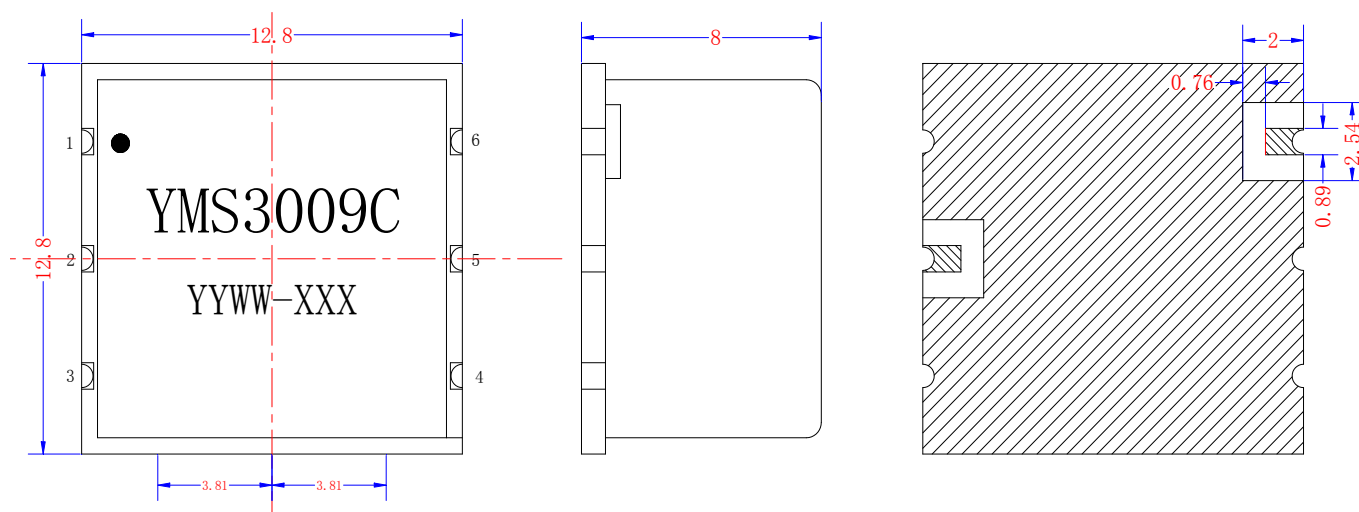
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
输出频率	f_{out}	输出端口阻抗: 50Ω 工作电压: 5V (相噪测试: @10KHz)		1060		MHz	
频率稳定度			-1		1	ppm	
输出功率	P_{out}		-2	0	+2	dBm	
杂散抑制			60			dBc	
谐波抑制			40			dBc	
相位噪声	PN				-95	dBc/Hz	
电源电压	V_{cc}		+4.5	+5	+5.5	V	
电源电流	I_{cc}	$V_{\text{cc}}=+5\text{V}$		110	130	mA	
质量	m				3	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+6	V	工作温度	-55~+85	°C
贮存温度	-60~+105	°C			

封装外形图:

单位: mm 公差: $\pm 0.2\text{mm}$



字符标志及引脚定义：

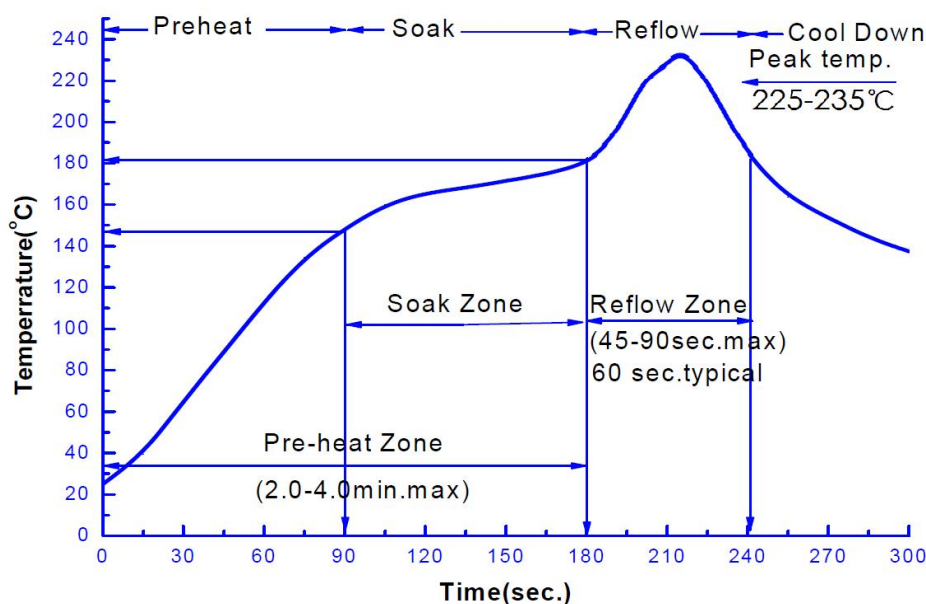
字符	定义
YMS3009C	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号
●	1 脚
	接地

引脚定义：

引脚	定义	备注
1	Vcc	+5V 电源
5	RFout	射频输出
2/3/4/6	GND	接地

产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
3. 对于采用 PCB+屏蔽罩组合封装的产品，如拆包后未使用完，需及时进行密封处理，如有包装有漏封，产品使用前建议按照 125℃，时间 4 小时进行烘烤，避免 PCB 因吸潮而导致 SMT 时 PCB 内部分层。
4. 产品焊接时请保证良好的接地（GND 引脚和底部金属化区域均需进行焊接），保证射频信号接地的同时，也保证产品机械固定的可靠性。
5. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，

实测回流基板温度不得超过 235℃。

6. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
7. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
8. 印制板和屏蔽罩组合式的产品属于非密封器件，客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，保证产品上的缝隙及输入/输出孔口完全被覆盖，以提高产品耐环境适应性能力。
9. 其他产品使用注意事项参考各《产品使用注意事项》相关要求。